

カッティングエッジ

CUTTING EDGE

73期中間事業のご報告

平成23年4月1日～平成23年9月30日

証券コード6146



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

Cutting Edgeという言葉には、「刃の先端」「最先端」という意味があります。ディスコが創業当初より「砥石(刃)」を作り続けることで培い、受け継いできたモノづくりへの熱意を糧に、これからの最先端の技術領域を切り拓いていきたいという思いを、このタイトルに込めました。

本誌では、ディスコの業況や経営方針、財務状態や最新技術情報などを株主のみなさまにタイムリーにお伝えしていきます。



会社概要



株式情報

株式会社 **ディスコ**



社長メッセージ

変化に速やかに対応できる組織を目指して さらなる進化を実現してまいります。

事業環境・業績

2011年度上半期の経済動向は、欧米経済の景気減速懸念により先行き不透明感が強まりました。当社グループが主力事業を展開している半導体業界においても、景気の先行き懸念からパソコンや薄型テレビなどの最終製品需要が想定より伸びず、半導体の在庫が積み上がったことで、半導体メーカ各社に設備投資抑制の動きがみられました。

当社グループでは期後半から台湾・韓国・中国などアジアの半導体メーカからの装置受注の落ち込みがみられたものの、世界的ヒット商品であるスマートフォン関連の設備投資は活発でした。また、当社のKiru・Kezuru・Migakuソリューションが幅広い顧客ニーズに合致し、電子部品向けブレードダイサ、メモリ向け薄化グラインダの出荷が堅調だったうえ、消耗品である精密加工ツールも薄化技術ニーズの進展などの影響もあり高水準な出荷が継続しました。

この結果、売上高は2010年度上期に次ぐ過去2番目の水準となりましたが、歴史的な円高により、当社も収益性が悪化し、前年度より営業利益率・経常利益率ともに低下することとなりました。

企業体質の強化のための取り組み

当社では、2004年度より毎年5%構造的経費削減に全社的に取り組んでまいりました。これは各部門で知恵を絞り、従来の仕事のやり方を変えることによって前年度の経費の5%を削減していく活動です。こうした地道な活動が、現在のような厳しい市場環境の中にあっても収益を確保できる体制を支えていると考えております。今後とも、従業員ひとりひとりの知恵を大切にしながら、効率的な業務運営を推進してまいります。

また、東日本大震災によりサプライチェーンの寸断が発生しましたが、サプライヤー各社様の迅速な対応もあり大きな混乱には至らず、お客様への安定供給体制を維持することができました。当社は事業継続マネジメント(BCM)を策定し、地震やパンデミックといったリスクに対して備えてきましたが、今回の震災に直面し、取り組みが不十分な点や、運用面にさらなる工夫をする必要がある点があることに気づかされました。こうした教訓を今後の事業経営に反映していくつもりです。

今後の見通し

現在、欧州の債務危機の長期化などにより、景気の先行きは予断を許さない状況で、半導体市場も調整局面を迎えております。当社を取り巻く環境も厳しくなっておりますが、将来へ向けた取り組みを今後も継続してまいります。具体的には、先端技術ニーズを満たすべく研究開発するのに加え、シンガポール・台湾・中国などのアジア地域の販売拠点でのアプリケーション力の向上、さらに生産対応力・サプライチェーンの強化を図ってまいります。

株主のみなさまにおかれましては、一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2011年12月

代表取締役社長 関家一馬



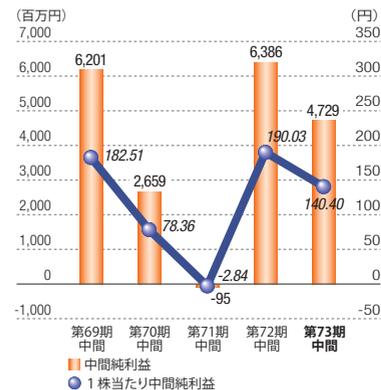


財務ハイライト

売上高・経常利益・経常利益率



中間純利益・1株当たり中間純利益



総資産・自己資本比率



配当金・配当性向



当期の概況

当中間期のハイテク業界においては、スマートフォンの世界的な普及に後押しされ、携帯端末に使用されるデバイスを中心に生産設備の拡張が積極的に行われ、当社の精密切断装置、精密研削装置とも出荷は高水準で行われました。また、LED加工用装置も前年同期と比べ落ち込みはみられたものの、底堅い売上推移となりました。精密加工ツールについても、期初は東日本大震災の影響を受け、一時的に需要が大幅に高まりましたが、早期に混乱は収束し、その後は大きな落ち込みもなく堅調な売上推移となりました。その一方で、円高の大幅な進行による外貨建て取引の収益が圧迫されたものの、6ヶ月累計期間としては比較的高い水準の売上高となりました。

以上の結果、当中間期の業績は売上高484億37百万円（前年同期比9.3%減）、営業利益69億1百万円（同28.6%減）、経常利益71億10百万円（同27.3%減）、中間期純利益47億29百万円（同25.9%減）となりました。

■財政状態について

当中間期末の総資産は、前期末と比較して7億94百万円増加して1,400億34百万円となりました。これは、売上債権の回収が進み受取手形及び売掛金が減少した一方で、現預金や棚卸資産の増加、精密加工ツール新棟の建設仮勘定が増加したことによるものです。負債は、支払債務が増加した一方で法人税の支払いに伴い未払法人税などが減少したことから、前期末と比較して18億74百万円の減少となる397億31百万円となりました。純資産は、利益剰余金が前期末より33億75百万円増加したことなどにより、1,003億3百万円となりました。この結果、

自己資本比率は、前期末比1.5ポイント増となる70.9%となりました。

■配当について

当社は業績に連動した配当を実施することを基本方針とし、期末・中間期末の年2回に、連結半期純利益の20%を配当いたします。また、利益水準に関わらず安定配当として半期10円（年間20円）を維持いたします。ただし、3期連続で連結純損失の場合を除きます。なお、4年累計連結売上高経常利益率が20%を超えた場合、通常20%の配当性向を24%にいたします。

当中間期末の配当につきましては、配当政策に基づき、1株当たり29円とさせていただきます。

通期の連結業績予想

現在、欧州債務危機の長期化などにより、世界全体の経済成長が鈍化する傾向が見られております。当社が事業展開しているハイテク業界においても、サブコンを中心に投資を手控える動きが急速に広がっております。そのような市場環境の変化を受け、2012年3月期の業績見通しを修正いたします。為替レートは1ドル75円を前提とし、連結業績は63億円の当期純利益を見込んでいます。

2012年3月期 (金額の単位：百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
89,300	10,100	10,300	6,300	186.97円



新製品の紹介

さらなる**薄型化・小型化・効率化**の実現、そして未来の快適を担う
グリーンデバイス※向けの**新たなKKMテクノロジー**を発表しました。

※LEDやパワー半導体など環境負荷低減に役立つ半導体素子

DFL7360FH

従来のステルスダイシング2機種に加え、新たにφ300mm対応のリングフレーム搬送機構を有したレーザーDFL7360FHを開発しました。DFL7360FHは今後300mmウェーハでの生産が見込まれるICタグやラインセンサーなどの薄型小チップデバイスをターゲットとしています。ステルスダイシングの特性を活かした切幅の大幅な削減により、一枚のウェーハから取れるチップ個数の増加が期待できるほか、リングフレーム搬送を採用していることから、既存のプロセスからの置き換えが容易で、マウンタ・ダイボンダなどの前後工程とのスムーズな受渡しが可能となります。



DFG8830

DFG8830は、4つの研削軸(スピンドル)を有するフルオートグラインダです。4つの軸にさまざまなホイール・研削条件を割り振ることができるため、様々な加工ニーズに柔軟に対応が可能です。またコンパクトな設計を追求し、研削軸への門型構造の採用や搬送部レイアウトの最適化によって省フットプリントを実現しています。ウェーハの大口径化が進んでいるLED用のサファイヤやハイブリッドカー・電気自動車やエアコンなどに使用されるパワー半導体の基板となるSiC(炭化ケイ素)といった加工難易度の高い硬脆材料の自動研削加工・枚葉加工ニーズに応える装置です。



DFD6560

ディスコの主力製品であるφ300mmウェーハ用フルオートダイシングソーに超小型のDFD6560が加わりました。新開発のショートスピンドルを採用したうえ、装置内レイアウトを最適化した結果、従来機比でフットプリントを16%削減しました。また、メンテナンス箇所を前面に集中したことで、従来の側面メンテナンスエリアが不要となるため、より効率的に生産スペースを活用することができます。





ディスコの技術が支えるスマートフォン

スマートフォンに搭載される半導体・電子部品の多くは ディスコのKiru・Kezuru・Migakuソリューションを利用しています。

半導体市場はシリコンサイクルという大きな需要の山谷がある厳しい環境ですが、さまざまな技術革新を遂げながら成長を続けています。近年では大きく生活を変えたハイテク製品の代表格ともいえるスマートフォンが、現在の半導体市場を牽引するアプリケーションとなってきました。

特に、昨年発表された米国Apple社のiPhone 4は世界的な大ヒット商品となりました。スマートフォン市場は大きく拡大しており、2011年は全世界で約4億台、2012年には5.5億台～6億台

にまで増加すると試算されています。

スマートフォンの特徴は、その多機能性です。これまでの携帯電話と同様の通話・メール・カメラ機能に加えて、パソコンと同じようなインターネット閲覧が可能であり、音楽プレーヤ機能もついています。さらに、無数にあるアプリケーションソフトをダウンロードすることで、機能をカスタマイズして利用することが可能です。そのため、スマートフォンは、パソコン並みの性能を求められることから、従来の携帯電話と比較して2～3倍の電子部品や処理能力の

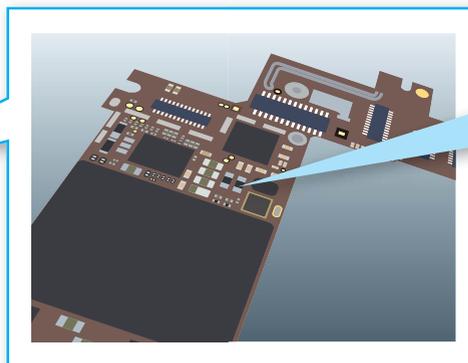
高い半導体チップを必要とします。これら数多くの半導体や電子部品の極小化・極薄化に貢献しているのが、ディスコのKiru・Kezuru・Migaku技術です。

例えば、極薄グラインディング技術は撮影した写真やダウンロードした音楽を保存するメモリの大容量化を可能にしています。また、デジタルカメラ並みの撮影機能の高度化にも、同様にディスコの技術が役立てられています。

スマートフォンに用いられるKKM技術のイメージ図



スマートフォン



スマートフォンに搭載されている基板



ディスコのKKMソリューション

基板の中に幾つも使われている半導体チップ。その1つ1つを高精密に切断し、さらに薄く研削することで、最終製品の小型化や高機能化が可能になります。

研究開発費

2011年度の研究開発費は 過去最高を更新する見通しです。

世界中のお客様から「KKMならディスコ」という期待に応えるために、ディスコでは、高度なKiru・Kezuru・Migaku技術の研究開発を積極的に行っています。

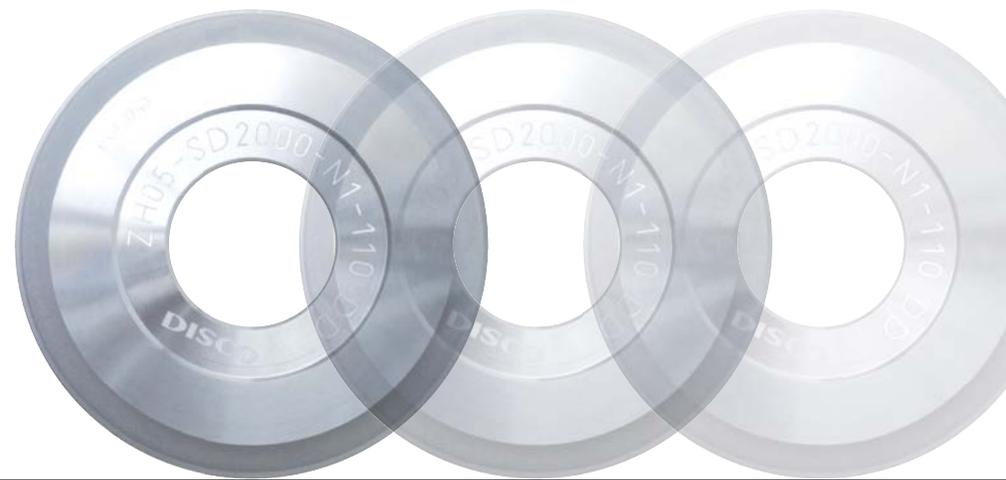
研究開発費用は、9割以上が主力事業の精密加工システム事業に関わる費用であり、主に半導体や電子部品などの微細加工に使用される精密加工装置や精密加工ツール(消耗品)、アプリケーション技術の研究開発に充てられています。現在は、デバイスの省電力化やさらなる小型化・薄型化を実現するための開発テーマを数多く取り組んでいます。

研究開発費





「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」



3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術とは

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという強い思いが込められているからです。

遠い科学を身近な快適につなぐとは

科学は日進月歩しています。しかしどれほど技術が進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダとの価値交換を通じ、長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。